杭州士兰微电子股份有限公司

【2012】年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	士兰微	股票代码	600460
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈越	马良	
电话	0571-88210880	0571-88212980	
传真	0571-88210763	0571-88210763	
电子信箱	600460@silan.com.cn	ml@silan.com.cn	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	3,350,408,146.52	3,317,450,616.71	0.99	2,564,948,734.53
归属于上市公司股东的净资产	1,696,892,031.27	1,709,626,387.46	-0.74	1,658,726,568.91
经营活动产生的现金流量净额	168,159,848.74	220,434,981.70	-23.71	303,881,858.40
营业收入	1,349,024,202.50	1,545,988,665.82	-12.74	1,518,826,971.05
归属于上市公司股东的净利润????	18,273,006.58	153,221,469.72	-88.07	255,858,649.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-47,469,931.67	126,454,728.77	-137.54	222,732,219.22
加权平均净资产收益率(%)	1.08	9.08	减少8.00个百分点	23.54
基本每股收益(元/股)	0.02	0.18	-88.89	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.18	-88.89	0.31

2.2 前10名股东持股情况表 单位：股

报告期股东总数	48,596	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	60,611

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
杭州士兰控股有限公司	境内非国有法人	47.21	409,878,146		质押45,600,000
陈向东	境内自然人	1.42	12,311,612		无
范伟宏	境内自然人	1.22	10,556,820		无
郑少波	境内自然人	1.20	10,418,600		无
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	未知	1.15	10,000,000		无
江忠永	境内自然人	0.96	8,300,000		无
罗华兵	境内自然人	0.82	7,111,420		无
申倩	未知	0.69	6,000,000		无
国华人寿保险股份有限公司-自有资金	未知	0.69	6,000,000		无
宋卫权	境内自然人	0.48	4,210,000		无

上述股东关联关系或一致行动的说明：截至报告期末，在册持有本公司股份前十名无限售条件股东中的陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵、宋卫权等六人为本公司第一大股东杭州士兰控股有限公司股东。其他持有无限售条件股东未知是否存在关联关系。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、管理层讨论与分析

（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年，公司营业收入为134,902万元，较2011年下降12.74%；公司营业利润为-5,922万元，比2011年减少142.72%；公司利润总额为1,454万元，比2011年减少91.33%；公司归属于母公司股东的净利润为1,827万元，比2011年减少88.07%。

2012年是公司近三年来经营压力最大的一年。2012年前三个季度，公司营业收入都低于去年同期，且从2011年三季度开始，公司营业收入出现了连续三个季度的下滑。公司营业收入下降的主要原因是：受行业竞争加剧的影响，公司发光二极管产品的价格较去年同期有较大幅度的降低，导致发光二极管的营业收入大幅度减少。受外部经济下滑的影响，公司集成电路、分立器件芯片的销售收入也较去年有一定幅度的减少。2012年公司功率器件成品的营业收入保持了快速增长，这在一定程度上弥补了公司其他产品收入的下降。

9）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2012年，公司子公司士兰集成生产芯片124.97万片，比2011年减少13.65%；公司子公司士兰明芯生产发光二极管芯片9,439KK（百万颗），比2011年增加11.77%。

8）主要销售客户的情况

公司向前5名客户销售合计为34,505.44万元，占公司营业收入的25.57%。

公司的前五名客户分别是：杭州友旺电子有限公司，EXAR CORPORATION，东莞市中之进出口有限公司，Chengdu Shunyun Logistics CO.，LTD.，成都先进功率半导体股份有限公司。

3、成本

1）成本分析表 单位：元

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
电子元器件		1,047,480,905.16	100	1,066,688,819.38	100	-1.80

分产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
集成电路		410,519,822.72	39.19	410,566,686.07	38.49	-0.01
器件芯片		336,039,778.86	32.08	345,002,401.61	32.34	-2.60
器件成品		134,797,644.05	12.87	79,696,359.88	7.47	69.14
发光二极管		164,790,162.09	15.73	227,948,458.94	21.37	-27.71
其他		1,333,497.44	0.13	3,474,912.88	0.33	-61.63

说明：

1）集成电路和分立器件芯片制造成本构成

项目	2012年	2011年
主材	24.30%	30.58%
辅材	23.04%	23.53%
人工	18.48%	16.20%
制造费用	34.18%	29.69%
合计	100.00%	100.00%

2）发光二极管管芯片制造成本构成

项目	2012年	2011年
主材	20.62%	51.96%
辅材	24.30%	19.00%
人工	8.06%	4.59%
制造费用	47.02%	24.46%
合计	100.00%	100.00%

4、 费用

利润表项目	2012年	2011年	变动幅度(%)	变动原因
营业税金及附加	8,629,582.53	5,720,320.70	50.86	主要系本期长期资产总体投资减少，导致可抵扣进项税减少；相应应交流转税及其附加税上升所致。
投资收益	9,546,718.25	18,065,932.15	-47.16	主要系联营企业友旺电子公司本期净利润下降所致。
营业外收入	76,894,680.59	33,098,178.23	132.32	主要系本期收到的政府研发项目补助增加所致。
所得税费用	-5,426,410.67	12,093,111.56	不适用	主要系本期营业利润下降，相应应纳税所得额减少所致。
其他综合收益	-2,232,558.09	-75,076,748.98	不适用	主要系本期按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额变动较少所致。

5、 研发支出

1）研发支出情况表 单位：元

本期费用化研发支出	144,597,200.34
本期资本化研发支出	
研发支出合计	144,597,200.34
研发支出总额占净资产比例(%)	8.44
研发支出总额占营业收入比例(%)	10.72

6、 现金流 单位：元

现金流量表项目	2012年	2011年	变动幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	168,159,848.74	220,434,981.70	-23.71%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-254,028,128.81	-806,711,794.46	不适用	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少，以及理财产品到期赎回回笼资金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-30,610,286.38	439,914,773.01	-106.96	主要系上期发行6亿元公司债券募集资金所致。

（三）行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
电子元器件	1,343,489,555.83	1,047,480,905.16	22.03	-13.00	-1.80	减少8.89个百分点

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
集成电路	572,801,162.60	410,519,822.72	28.33	-4.59	-0.01	减少3.28个百分点
器件芯片	430,490,078.14	336,039,778.86	21.94	-11.15	-2.60	减少6.85个百分点
器件成品	161,629,847.44	134,797,644.05	16.60	63.99	69.14	减少2.54个百分点
发光二极管	174,744,391.49	164,790,162.09	5.70	-50.67	-27.71	减少29.95个百分点
其他	3,824,076.16	1,333,497.44	65.13	-41.40	-61.63	增加18.38个百分点

（四）核心竞争力分析

1、较为成熟的IDM模式

公司从集成电路芯片设计业务开始，逐步搭建了芯片制造平台，并已将产业链延伸至功率器件和功率模块的封装领域，建立了较为成熟的IDM（Integrated Design & Manufacture，设计与制造一体）经营模式。IDM模式可有效进行产业链内部整合，公司设计研发和工艺制造平台同时发展，形成了特殊工艺技术与产品研发的紧密互动，以及器件、集成电路和模块产品的协同发展。公司依托IDM模式形成的设计与工艺相结合的综合实力，提升产品品质、加强控制成本，向客户提供差异化的产品与服务，提高了其向大型厂商配套体系渗透的能力。

2、产品群协同效应

公司从IC设计企业完成了向综合性的半导体产品供应商的转变，在半导体大框架下，形成了功率器件、功率模块、集成电路、LED业务的协同发展，各业务之间相互补充、促进、借鉴。公司在产品销售时，可根据客户需求，给出满足客户需求的产品、组合和方案。进入LED业务之后，公司在集成电路业务中积累的技术、人才资源和管理经验，成为LED业务发展的后盾，公司还结合对两个领域较为深入的理解，推出了LED驱动电路系列产品，与LED芯片业务形成互动。

3、较为完善的技术研发体系

公司已经建立了可持续发展的产品和技术研发体系。公司的研发工作主要可分为两个部分：芯片设计研发与工艺技术研发。在芯片设计研发方面，公司以IPD（集成产品开发管理体系）为引导，依照产品的技术特征，将技术研发工作根据各产品线进行划分。公司持续推动新产品开发和产业化，根据市场变化不断进行产品升级和业务转型，保持了持续发展能力。在工艺技术平台研发方面，公司已开发并运用国内较为领先的BCD工艺制造平台，形成了自身的特殊工艺。这一方面保证了公司产品的品质及种类的多样性，提升了生产效率、有效降低成本；另一方面也支撑了公司电源管理、功率驱动、功率模块、功率器件、MEMS器件等各系列产品的研发。公司依托在半导体行业积累的技术和经验，将业务拓展至LED领域，攻克了芯片的ESD防护问题、图形化衬底、金属淀积质量、MOCVD外延参数均匀性等一系列技术关口，在提升产品品质的同时，有效的降低了生产成本。

4、面向全球品牌客户的品质控制

公司依托产品研发和工艺技术的综合实力提升和保证产品品质。公司还通过研发各项测试工艺，加强对各种封装形式的集成电路、功率器件、功率器件成品的测试能力。目前公司已经获得了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证、索尼GP认证、欧盟ROSH认证、ECO认证等诸多国际认证，产品已经得到了欧司朗、三星、LG、索尼、达科、巴可等全球品牌客户的认可。公司设计研发、芯片制造、测试系统的综合实力，保证了产品品质的优良和稳定，是公司参与市场竞争、开发高端市场、开发高品质大客户的保障。

五）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

1）国内半导体行业竞争格局

目前世界半导体行业向我国转移的趋势没有改变，我国已成为全球主要的半导体生产国家之一。境外大型半导体公司在国内投资快速增长，但技术、研发的导入却未能同步发展。出于对核心技术的保护，发达国家对关键技术和先进设备的输出对我国进行限制。外资厂商凭借其雄厚的资金实力和技术积累占据了较大的市场份额，并在某些高端半导体设计和制造方面甚至处于垄断地位。而我国半导体企业的技术积累和规模效应较国际大厂仍有较大差距，以代工为主要业务存在的中小厂企业较多，具有自主核心技术和先进生产工艺的企业较少，市场竞争手段以价格竞争为主。从半导体行业最为注重的规模效应来看，我国优势半导体企业仍亟待加强。

2）我国集成电路行业发展趋势

根据国家工业和信息化部发布的《集成电路产业"十二五"发展规划》："十二五"末，我国集成电路产业规模再翻一番以上，关键核心技术和产品取得突破性进展，形成一批具有国际竞争力的企业。"十一五"期间，我国集成电路产业规模持续扩大，产量和销售收入分别从2005年的265.8亿块和702亿元，提高到2010年的652.5亿块和1,440亿元，占全球集成电路市场比重从2005年的4.5%提高到2010年的8.6%。同时，创新能力显著提升，产业结构进一步优化，企业实力明显增强。工信部预计，到2015年，国内集成电路市场规模将超过1万亿元人民币。为实现集成电路产业健康持续发展，工信部提出，到"十二五"末，集成电路产量超过1,500亿块，销售收入达3,300亿元，年均增长18%，占世界集成电路市场份额的15%左右，满足国内近30%的市场需求。行业结构将进一步调整，将着重加强产业链上游建设，芯片设计业占全行业销售收入比重将提高到三分之一左右，芯片制造业、封装测试业比重将占三分之二。芯片的先进设计能力将达到22纳米，将开发一批具有自主知识产权的核心芯片，国内重点整机应用自主开发集成电路产品的比例将达到30%以上。同时，将继续强化以长三角、京津环渤海和泛珠三角的三大集聚区，以重庆、成都、西安、武汉为侧翼的产业布局，建成一批产业链完善、创新能力强、特色鲜明的产业集聚区。

3）2012年全球半导体市场概述

2012年，由于受到欧债危机等因素的影响，全球半导体行业整体较为低迷。根据美国半导体产业协会（SIA）引用世界半导体贸易统计组织（WSTS）资料所公布的最新统计数据，2012年全球半导体销售额总计达到2,916亿美元，较2011年的2,995亿美元减少2.7%，为近三年首次负增长。伴随着美国经济的逐步复苏，全球半导体市场在2012年四季度有所反弹。2012年四季度全球半导体销售额为742亿美元，较2011年同期增长3.8%。其中，美洲地区显示持续增长的态势，美洲地区四季度销售额同比增长12%，其12月份的销售额同比增长13.4%。亚太地区在四季度开始呈现触底迹象，亚太地区2012年12月的半导体销售额同比增长6.7%，已连续2个月高于上年同期。在美洲地区强劲增长的推动下，预计2013年全球半导体市场将进一步改善，WSTS预测2013年全球半导体市场销售额可增长4.5%。

2、公司面临发展的战略机遇期

近几年，全球金融危机、欧债危机的频频发生，使得全球经济增速放缓，这给国内经济的发展带来较大的外部压力。但从国际环境看，我国发展仍处于重要的战略机遇期。我们面临的机遇，不再是简单纳入全球分工体系、扩大出口、加快投资的传统机遇，而是倒逼我们扩大内需、提高创新能力、促进经济发展方式转变的新机遇。党的"十八大"提出"实施创新驱动发展战略"，将科技创新摆在国家发展全局的核心位置。士兰微电子经过十多年的发展，坚持走"设计制造一体化"道路，在多个产品技术领域构建了核心竞争优势。近几年，士兰微电子通过承担国家重大科技专项，在新技术新产品新工艺研发应用上取得重大突破，这为公司今后可持续发展增添了动力。随着人们对"绿色、节能、环保"的关注度的日益提高，推动了人类向节能型、环保型社会的转型，促进了以LED、智能功率器件和模块为代表的诸多半导体信息技术的快速发展，并在人民生活和传统产业节能、环保、信息化升级改造的过程中发挥了不可替代的重要作用。半导体信息技术在节能、环保领域的广泛的应用催生了半导体行业更为广阔的市场空间。士兰微电子将继续坚持IDM模式，紧紧抓住市场对节能、环保产品需求日益增长的战略机遇期，加快对智能功率模块、IGBT、LED照明芯片、电源驱动IC、MEMS器件等新产品的开发，大力推进系统创新和技术整合，不断提升产品的附加值，在创造良好经济效益的同时，积极创造社会效益。

3、公司发展战略

公司发展战略是：成为国内最大的自有品牌的半导体产品制造商。

- 在高压BCD工艺、高压分立器件的研发上加大投入，争取在AC-DC电源、LED照明驱动、功率模块等产品领域取得较大的进展，树立品牌，大幅度拓展市场。
- 继续在数字音视频（含安防监控、光盘伺服系统）领域投入，巩固并拓展应用市场。
- 继续全力推动特殊工艺研发、制造平台的发展，在特殊工艺领域坚持走IDM（设计与制造一体）的模式。继续推进成都半导体生产基地的建设，做好生产启动的各项准备工作。
- 加快推进功率模块的封装业务，充分发挥公司在高压电路与器件芯片研发、芯片制造、应用系统开发的综合优势，迅随高压、高功率产品应用市场的快速发展。
- 继续加大分立器件芯片的技术和产品研发投入，加快IGBT、MEMS等先进器件的开发，增加器件芯片的技术附加值。
- 持续在LED芯片领域投入，在LED彩屏芯片已取得较好优势的产业基础上，加快发展照明LED芯片业务。
- 打造士兰"美卡乐"高端LED成品品牌，积极拓展海内外高端客户，提升产品价值。

4、经营计划

1）公司的产品线规划

2013年公司产品线规划基本没有改变，将按六个方面进行规划、管理和运行：电源和功率驱动产品线、数字音视频产品线、MCU产品线、混合信号与射频产品线、分立器件产品线、LED器件产品线等。

2）对2013年营业总收入的预计

预计2013年公司将实现营业总收入17亿元左右（预计比2012年增长26%左右），营业总成本将控制在16亿元左右。

董事长：陈向东

杭州士兰微电子股份有限公司

2013年3月3日

证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2013-010

债券代码：122074 债券简称：11士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于2013年3月2日以电子邮件方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事11人，除裴长洪先生因参加政协会议而委托独立董事金小刚先生代为行使同意表决权外，其余董事均亲自出席本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议以现场表决的方式通过了以下决议：

1、2012年年度报告》及摘要；

全文详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

2、2012年度总经理工作报告；

表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。

3、2012年度董事会工作报告；

详细内容请见《2012年年度报告》。

表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

4、2012年度财务决算报告；

表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

5、2012年度利润分配预案；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2012年度共实现归属于母公司股东的净利润18,273,006.58元；依据《公司法》和公司章程的规定，提取10%法定公积金6,134,268.42元后，当年可供股东分配的利润为12,138,738.16元，加上上年结转未分配利润628,864,836.56元，减去本年已分配利润43,408,000元，累计可供股东分配的利润597,595,574.72元。

本公司2012年度的利润分配的预案为：公司2012年度拟不实施现金分红亦不派送红股，未分配利润结转以后年度分配。

2）我国集成电路行业发展趋势

根据国家工业和信息化部发布的《集成电路产业"十二五"发展规划》："十二五"末，我国集成电路产业规模再翻一番以上，关键核心技术和产品取得突破性进展，形成一批具有国际竞争力的企业。"十一五"期间，我国集成电路产业规模持续扩大，产量和销售收入分别从2005年的265.8亿块和702亿元，提高到2010年的652.5亿块和1,440亿元，占全球集成电路市场比重从2005年的4.5%提高到2010年的8.6%。同时，创新能力显著提升，产业结构进一步优化，企业实力明显增强。工信部预计，到2015年，国内集成电路市场规模将超过1万亿元人民币。为实现集成电路产业健康持续发展，工信部提出，到"十二五"末，集成电路产量超过1,500亿块，销售收入达3,300亿元，年均增长18%，占世界集成电路市场份额的15%左右，满足国内近30%的市场需求。行业结构将进一步调整，将着重加强产业链上游建设，芯片设计业占全行业销售收入比重将提高到三分之一左右，芯片制造业、封装测试业比重将占三分之二。芯片的先进设计能力将达到22纳米，将开发一批具有自主知识产权的核心芯片，国内重点整机应用自主开发集成电路产品的比例将达到30%以上。同时，将继续强化以长三角、京津环渤海和泛珠三角的三大集聚区，以重庆、成都、西安、武汉为侧翼的产业布局，建成一批产业链完善、创新能力强、特色鲜明的产业集聚区。

3）2012年全球半导体市场概述

2012年，由于受到欧债危机等因素的影响，全球半导体行业整体较为低迷。根据美国半导体产业协会（SIA）引用世界半导体贸易统计组织（WSTS）资料所公布的最新统计数据，2012年全球半导体销售额总计达到2,916亿美元，较2011年的2,995亿美元减少2.7%，为近三年首次负增长。伴随着美国经济的逐步复苏，全球半导体市场在2012年四季度有所反弹。2012年四季度全球半导体销售额为742亿美元，较2011年同期增长3.8%。其中，美洲地区显示持续增长的态势，美洲地区四季度销售额同比增长12%，其12月份的销售额同比增长13.4%。亚太地区在四季度开始呈现触底迹象，亚太地区2012年12月的半导体销售额同比增长6.7%，已连续2个月高于上年同期。在美洲地区强劲增长的推动下，预计2013年全球半导体市场将进一步改善，WSTS预测2013年全球半导体市场销售额可增长4.5%。

2、公司面临发展的战略机遇期

近几年，全球金融危机、欧债危机的频频发生，使得全球经济增速放缓，这给国内经济的发展带来较大的外部压力。但从国际环境看，我国发展仍处于重要的战略机遇期。我们面临的机遇，不再是简单纳入全球分工体系、扩大出口、加快投资的传统机遇，而是倒逼我们扩大内需、提高创新能力、促进经济发展方式转变的新机遇。党的"十八大"提出"实施创新驱动发展战略"，将科技创新摆在国家发展全局的核心位置。士兰微电子经过十多年的发展，坚持走"设计制造一体化"道路，在多个产品技术领域构建了核心竞争优势。近几年，士兰微电子通过承担国家重大科技专项，在新技术新产品新工艺研发应用上取得重大突破，这为公司今后可持续发展增添了动力。随着人们对"绿色、节能、环保"的关注度的日益提高，推动了人类向节能型、环保型社会的转型，促进了以LED、智能功率器件和模块为代表的诸多半导体信息技术的快速发展，并在人民生活和传统产业节能、环保、信息化升级改造的过程中发挥了不可替代的重要作用。半导体信息技术在节能、环保领域的广泛的应用催生了半导体行业更为广阔的市场空间。士兰微电子将继续坚持IDM模式，紧紧抓住市场对节能、环保产品需求日益增长的战略机遇期，加快对智能功率模块、IGBT、LED照明芯片、电源驱动IC、MEMS器件等新产品的开发，大力推进系统创新和技术整合，不断提升产品的附加值，在创造良好经济效益的同时，积极创造社会效益。

3、公司发展战略

公司发展战略是：成为国内最大的自有品牌的半导体产品制造商。

- 在高压BCD工艺、高压分立器件的研发上加大投入，争取在AC-DC电源、LED照明驱动、功率模块等产品领域取得较大的进展，树立品牌，大幅度拓展市场。
- 继续在数字音视频（含安防监控、光盘伺服系统）领域投入，巩固并拓展应用市场。
- 继续全力推动特殊工艺研发、制造平台的发展，在特殊工艺领域坚持走IDM（设计与制造一体）的模式。继续推进成都半导体生产基地的建设，做好生产启动的各项准备工作。
- 加快推进功率模块的封装业务，充分发挥公司在高压电路与器件芯片研发、芯片制造、应用系统开发的综合优势，迅随高压、高功率产品应用市场的快速发展。
- 继续加大分立器件芯片的技术和产品研发投入，加快IGBT、MEMS等先进器件的开发，增加器件芯片的技术附加值。
- 持续在LED芯片领域投入，在LED彩屏芯片已取得较好优势的产业基础上，加快发展照明LED芯片业务。
- 打造士兰"美卡乐"高端LED成品品牌，积极拓展海内外高端客户，提升产品价值。

4、经营计划

1）公司的产品线规划

2013年公司产品线规划基本没有改变，将按六个方面进行规划、管理和运行：电源和功率驱动产品线、数字音视频产品线、MCU产品线、混合信号与射频产品线、分立器件产品线、LED器件产品线等。

2）对2013年营业总收入的预计

预计2013年公司将实现营业总收入17亿元左右（预计比2012年增长26%左右），营业总成本将控制在16亿元左右。

董事长：陈向东

杭州士兰微电子股份有限公司

2013年3月3日

证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2013-011

债券代码：122074 债券简称：11士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州士兰微电子股份有限公司第五届监事会第二次会议通知于2013年2月21日以电子邮件方式发出，并以电话确认，会议于2013年3月3日在本公司三楼小会议室召开。全体监事出席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由宋卫权先生主持，经与会监事的认真审议，以现场表决的方式通过了以下议案：

1、2012年年度报告及摘要》；

全文详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

2、2012年度监事会工作报告》；

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

3、2012年度财务决算报告》；

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

4、关于2012年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2012年度共实现归属于母公司股东的净利润18,273,006.58元；依据《公司法》和公司章程的规定，提取10%法定公积金6,134,268.42元后，当年可供股东分配的利润为12,138,738.16元，加上上年结转未分配利润628,864,836.56元，减去本年已分配利润43,408,000元，累计可供股东分配的利润为597,595,574.72元。

本公司2012年度的利润分配的预案为：公司2012年度拟不实施现金分红亦不派送红股，未分配利润结转以后年度分配。

公司所处的半导体行业属于资金密集型行业，且公司处于较快的发展时期，公司设计制造一体化的模式需要较多的资金用于研发及生产活动。受行业及其它外部环境的影响，公司2012年实现净利润数额较少。为谋求给公司股东带来长期的回报，公司拟将留存的未分配利润用于成都士兰一期工程项目建设和各类产品研发项目支出。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

5、2012年度关于公司内部控制的自我评估报告》；

全文详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、2012年度社会责任报告》；

全文详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、关于2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

全文详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、关于2012年年度报告审核意见的议案》。

公司监事会对公司2012年年度报告进行审核后认为公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；参与年报编制和审议的人员未有违反保密规定的行为。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司监事会

2013年3月5日

证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2013-012

债券代码：122074 债券简称：11士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司
2013年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

•公司与关联方杭州友旺电子有限公司的日常关联交易尚需获得股东大会的批准；公司与关联方杭州士腾科技有限公司、苏州君赢电子科技有限公司的日常关联交易无需提交股东大会审议。

•公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司第五届董事会第三次会议于2013年3月3日召开，会议审议通过了《关于与友旺电子日常关联交易的议案》、《关于与士腾科技日常关联交易的议案》、《关于与苏州君赢日常关联交易的议案》。在审议杭州友旺电子有限公司的关联交易议案中，公司关联董事陈向东、郑少波、范伟宏、江忠永、罗华兵回避表决；在审议杭州士腾科技有限公司的关联交易议案中，公司关联董事陈向东、郑少波、范伟宏、江忠永、罗华兵回避表决；在审议苏州君赢电子科技有限公司的关联交易议案中，公司关联董事陈向东、郑少波、范伟宏、江忠永、罗华兵回避表决；其余董事一致表决通过了上述议案。

2、公司独立董事裴长洪、金小刚、朱大中、黄光海、冯晓对上述关联交易进行了事前审核，并发表独立意见，认为公司与上述关联方的日常关联交易遵循了公平交易的市场原则，遵循了公司章程中有关关联交易决策权力与程序的规定，是合法的。

3、公司与关联方杭州士旺电子有限公司的日常关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）2012年日常关联交易的预计和执行情况 单位：人民币元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	交易金额	
			2012年预计金额	2012年实际发生金额
杭州友旺电子有限公司	销售货物	芯片加工	不超过2亿元	1.3亿元
杭州士腾科技有限公司	销售货物	芯片销售	不超过3,000万元	435万元
杭州士腾科技有限公司	采购货物	电路采购	不超过1,000万	81万元
杭州士腾科技有限公司	委托设计服务	接受委托设计服务	未来三年不超过800万	200万元
苏州君赢电子科技有限公司	销售货物	芯片销售	不超过1,200万元	880万元

（三）2013年日常关联交易预计金额和类别 单位：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2013年预计金额
杭州友旺电子有限公司	销售货物	芯片加工	不超过2.2亿元
杭州士腾科技有限公司	销售货物	芯片销售	不超过3,000万元
杭州士腾科技有限公司	采购货物	电路采购	不超过1,000万
苏州君赢电子科技有限公司	销售货物	芯片销售	不超过3,500万元

二、关联方介绍和关联关系

（一）杭州友旺电子有限公司

1、法定代表人：高脉辉

2、注册资本：300万美元

3、公司地址：浙江省杭州市滨江区环兴路1号

4、经营范围：半导体集成电路和分立器件的生产、销售和应用服务。

5、关联关系：杭州友旺电子有限公司系本公司联营企业，本公司所占比例为40%。本公司董事长陈向东先生在该公司任副董事长；本公司董事罗华兵先生在该公司任董事、总经理。

（二）杭州士腾科技有限公司

1、法定代表人：陈向东

2、注册资本：1000万

3、公司地址：浙江省杭州市黄姑山路4号14号楼2楼

4、经营范围：技术开发、技术服务；与微控制器、分级处理器产品有关的系统方案及软件、嵌入式系统集成及软件；生产：微处理器；批发、零售：微控制器、微处理器以及与之相关的集成电路和电子元器件；货物进出口；含下属分支机构经营范围；其他无需报经批准的一切合法项目。

5、关联关系：杭州士腾科技有限公司系本公司参股企业，本公司所占比例为10%。本公司董事长陈向东先生在该公司任董事长，本公司董事郑少波先生在该公司任董事。

（三）苏州君赢电子科技有限公司

1、法定代表人：宋卫权

2、注册资本：人民币500万元

3、公司地址：苏州工业园区星湖街328号创意产业园1-B602

4、经营范围：集成电路设计；软件、半导体产品开发；销售：电子产品及配件，计算机软件，半导体产品及配件、原料，化工产品及原料，机械，五金交电，通讯器材，金属材料，建材；从事上述产品的进出口业务；投资咨询。

5、关联关系：苏州君赢是本公司的控股股东杭州士兰控股有限公司（以下简称"士兰控股"）的参股企业，士兰控股持有其17%的股权，同时士兰控股的控股子公司——杭州士鹏科技有限公司持有其50%的股权。本公司监事会主席宋卫权先生担任该公司董事长。

（四）关联方的履约能力分析：上述关联方均依法持续经营，经营状况良好，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方进行的各项货物采购、销售、技术开发关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格执行。

公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司与杭州友旺电子有限公司拟签订《委托加工合同》。该协议自股东大会审议表决通过后，开始正式生效，有效期为一年。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

杭州友旺电子有限公司是本公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司的重要客户，杭州士腾科技有限公司和苏州君赢电子科技有限公司系本公司稳定客户，公司与上述各方均有着良好的合作关系；公司与上述关联方之间的交易是公允的，对公司完成2013年生产销售计划有积极影响；该交易不会损害公司的利益，对公司的独立性没有影响。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2013年3月5日

证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2013-013

债券代码：122074 债券简称：11士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

•募集资金存放是否符合公司规定：是

•募集资金使用是否符合承诺进度：不适用

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》